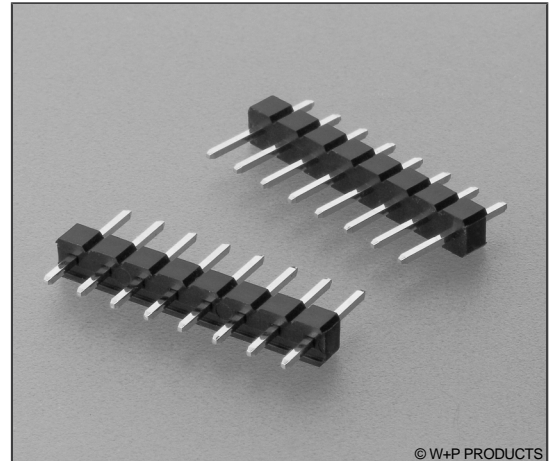


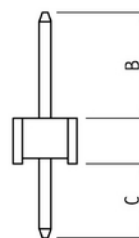
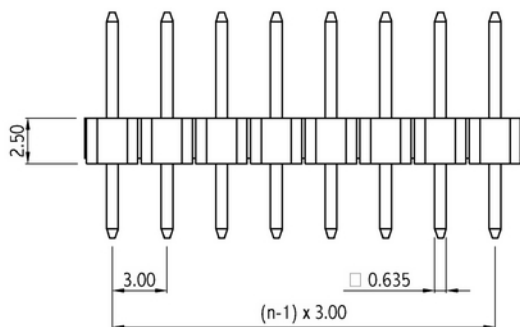
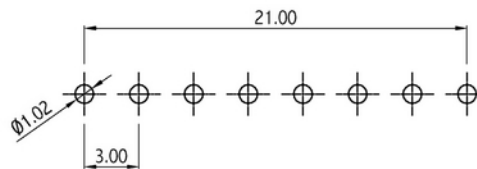
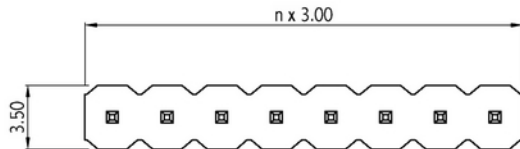
Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplast, UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Vierkantstift 0,635mm, Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>0.635mm square pin, copper alloy</i>
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
<i>Contact Surface</i>	<i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
<i>Contact Resistance</i>	<i>< 20mΩ</i>
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	<i>> 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit	500V _{AC}
<i>Test Voltage</i>	<i>500V_{AC}</i>
Nennstrom	3A
<i>Current Rating</i>	<i>3A</i>
Temperaturbereich	-40°C ... +125°C
<i>Temperature Range</i>	<i>-40°C ... +125°C</i>
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
<i>Processing</i>	<i>Wave or reflow soldering</i>



© W+P PRODUCTS

Recommended PCB Layout



Series

973

Type*

13

10 B=5.20 C=2.50mm
 12 B=5.50 C=3.30mm
 13 B=6.80 C=3.30mm
 Weitere Optionen auf Anfrage!
 More Options available!

Contacts*

012

001-040

Plating*

00

00 Au
 50 Sn
 60 Sel. Au/Sn

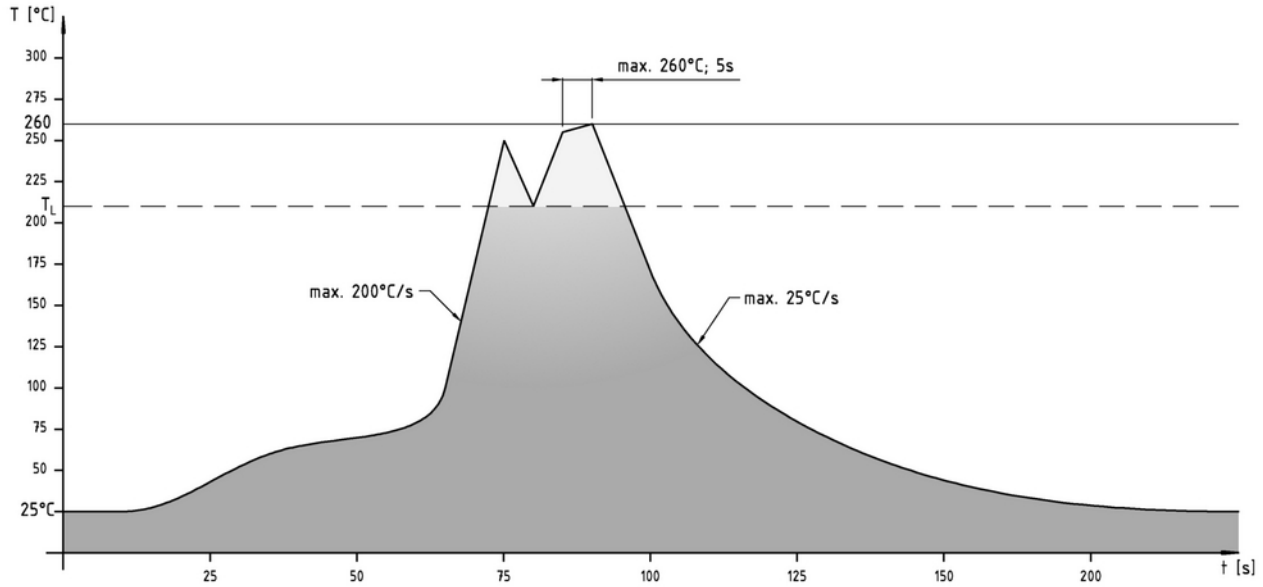
* Dies ist ein **Bestellbeispiel** - bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
 * This is an **order example** - please replace by your specifications.

Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.
Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.

Empfohlenes Wellenlötprofil:
Recommended wave soldering profile:



Reflow-Lötempfehlung

Reflow Soldering Recommendation

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum T_{Smin}	150°C
Temperatur Maximum T_{Smax}	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich T_L	217°C
Verweildauer oberhalb T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur T_P	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur T_P	Max. 8 min

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature T_{Smin}	150°C
Maximum Temperatur T_{Smax}	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature T_L	217°C
Duration above T_L	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature T_P	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. T_P	Max. 8min

